

证券代码：300460

证券简称：惠伦晶体

公告编号：2020-101

广东惠伦晶体科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2020年9月18日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于2020年9月15日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议由公司董事长赵积清先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

一、董事会会议审议情况

经参会董事认真审议，会议通过如下决议：

1、审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》

根据公司业务发展及资金情况，为满足经营发展需求，促进业务持续稳定发展，公司拟向兴业银行东莞分行（以下简称“兴业银行”）申请人民币9000万元的授信额度，用于补充流动资金。

截至目前，公司已累计获得银行等各类金融机构及融资租赁机构（不含安徽正奇融资租赁有限公司及其一致行动人）综合授信额度1.5亿元。本次向兴业银行申请9000万元授信额度后，累计综合授信额度将超过给予董事长赵积清先生的授权（不超过2亿元），但仍在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生为准。董事会授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的全部文书。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

《关于向银行申请授信的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

1、第三届董事会第十八次会议决议

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

2020年9月18日